

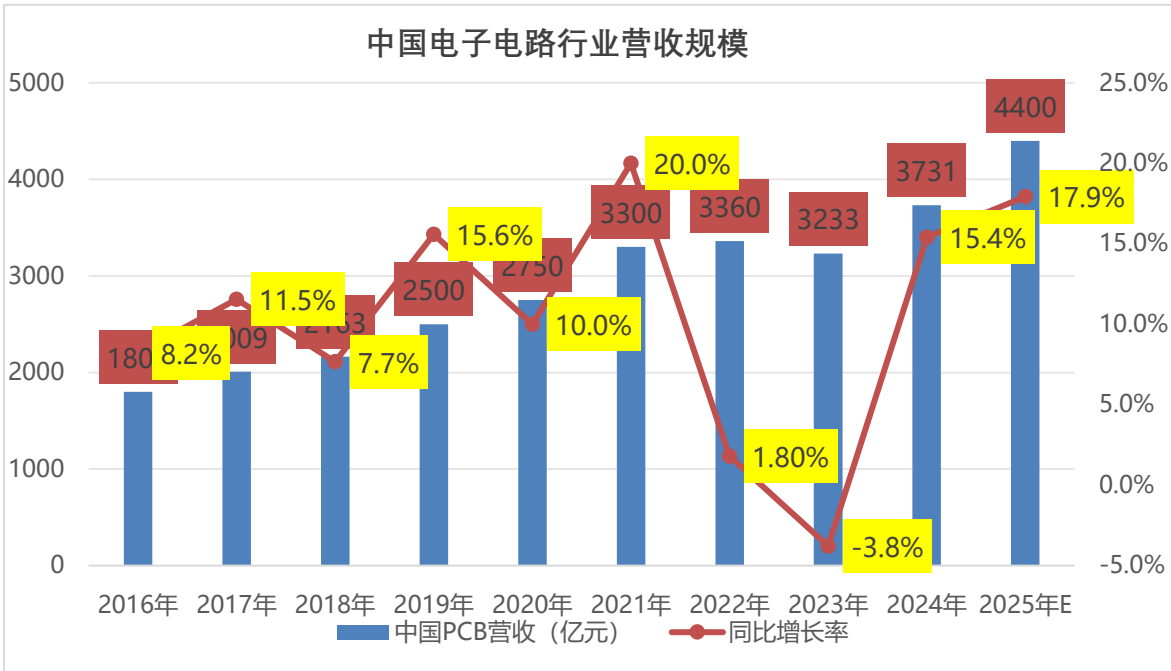
# 上海市电子电路行业协会 2025 年度行业运行情况

## 一、2025 年电子电路行业运行动态

2025 年，受 AI 技术迭代驱动，全国电子电路行业整体呈现高速增长态势，上海地区产业规模稳步回升，龙头企业积极布局升级亮点突出，行业发展格局呈现高端化、差异化特征，同时也面临供需结构调整与竞争压力，以下为具体运行情况及趋势研判。

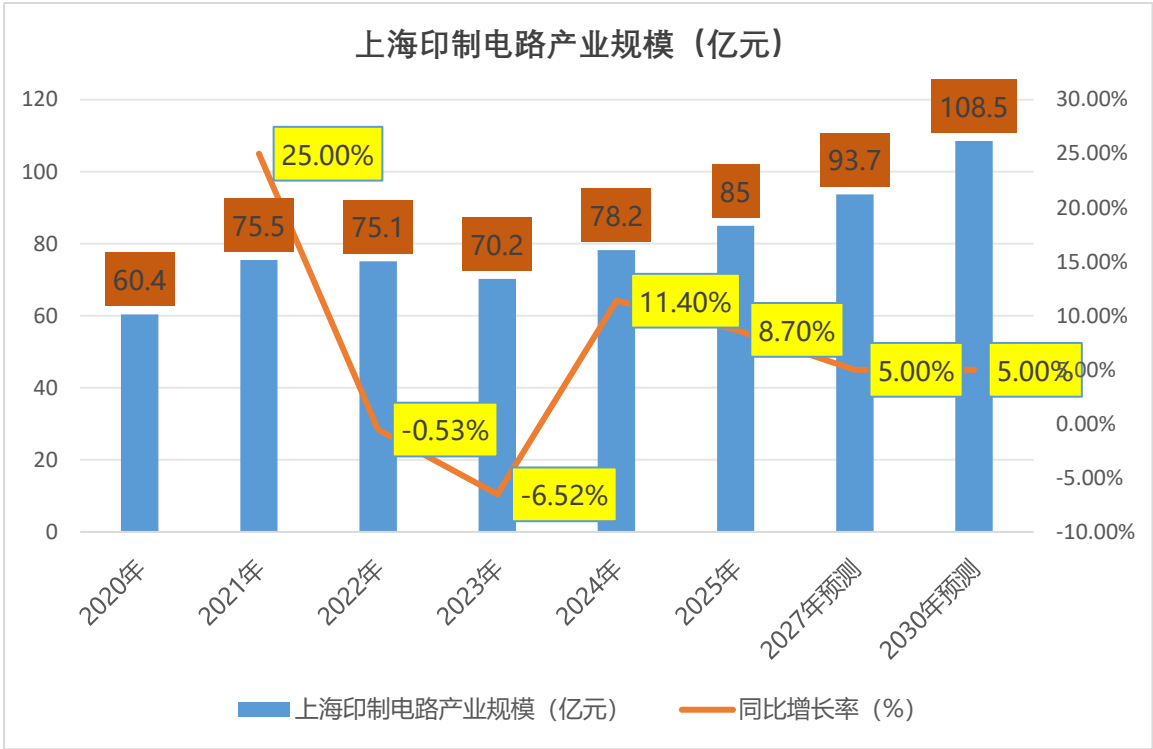
### （一）行业整体增长态势强劲

在 AI 技术的强劲驱动下，人工智能训练和推理需求持续扩大，AI 算力、AI 服务器市场需求激增，直接带动 PCB 行业的规模扩张与技术升级。据协会测算，2025 年前三季度全国电子电路产值约 2975 亿元，同比增长 12.7%；预计全年 PCB 制造增速区间为 15%-20%，产值可达 4400 亿元。从历年增长数据来看，2025 年全国 PCB 行业同比增长率高达 17.93%，延续了 2024 年以来的复苏增长态势。



### （二）上海地区产业规模稳步提升

2025 年上海线路板制造企业营收达 85 亿元，2021-2025 年年均复合增长率为 3.01%。基于当前发展基础，以 5.0% 年均复合增长率预测，2027 年上海 PCB 产业规模将达 93.7 亿元，2030 年预计突破 108.5 亿元。从区域增长趋势来看，2025 年上海 PCB 行业增长率为 8.70%，虽受前期市场波动影响，但在 AI 产业带动下已重回稳健增长轨道。



从协会调研数据来看，2025 年营收均处于增长态势，增长率约为 8.7%。从协会统计的 8 家上海地区 PCB 制造企业单个来看：合计营收约 85 亿元，其中增长较为明显的有：上海美维电子有限公司营收同比增长 20.0%，上海美维科技有限公司营收同比增长 16.0%，上海贺鸿电子科技股份有限公司营收同比增长 13.3%，上海嘉捷通电路科技股份有限公司同比增长 9.7%。

从下表来看，上海电子电路企业聚焦软硬结合线路板、高层多层印制电路板、HDI、封装基板等核心产品，覆盖中低端到高端全品类，终端应用渗透消费电子、通信、汽车电子、工业控制、半导体、航空航天等多个关键领域，形成了多元化、高端化的产业布局。

| 公司名称        | 主要生产产品                                 | 企业产品终端应用领域       |
|-------------|----------------------------------------|------------------|
| 上海建和电路板有限公司 | 1. 单/双面印制电路板；2. 多层印制电路板；3. 电子元器件       | 消费电子、工业控制设备、家用电器 |
| 上海美维科技有限公司  | 1. 封装基板；2. 球栅阵列（BGA）产品；3. 多芯片封装组件      | 半导体封装、智能手机、高端服务器 |
| 上海美维电子有限公司  | 1. 高层多层印制电路板；2. 高密度互连板（HDI）；3. 软硬结合线路板 | 消费电子、汽车电子、通信设备   |

|                 |                                                 |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 上海山崎电路板有限公司     | 1. 单/双面印制电路板；2. 多层印制电路板（最高 32 层）；3. 高密度互连板（HDI） | 通信基站、工业自动化设备、医疗电子设备 |
| 上海贺鸿电子科技股份有限公司  | 1. 高频高速 PCB；2. 高多层 PCB；3. 高频混压线路板               | 5G 通信、数据中心、雷达设备     |
| 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 | 1. 埋盲孔板；2. 高频微波板；3. 刚柔结合板                       | 航空航天电子、精密仪器、消费电子终端  |
| 上海展华电子（南通）有限公司  | 1. 车载板；2. 高密度互连板（HDI）；3. 软硬结合板                  | 新能源汽车、车载电子系统、智能驾驶设备 |
| 奥特斯中国有限公司       | 1. 高端 HDI 印刷电路板；2. 半导体封装基板；3. 软硬结合线路板           | 智能手机、半导体设备、人工智能服务器  |

（三）重点企业动态亮点纷呈

行业龙头企业积极布局升级，成为区域产业发展的核心引擎：

| 公司名称           | 2025 年上海地区核心动态                                  | 关键时间节点             |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 金安国纪科技股份有限公司   | 出资 6.16 亿元组建覆铜板集团，整合上海国纪电子材料等子公司，聚焦覆铜板主业集团化运营   | 2025 年 10 月 10 日   |
| 上海贺鸿电子科技股份有限公司 | 获奉贤区现代服务业发展专项资金支持，认定为总部经济企业，强化上海总部功能            | 2025 年 5 月         |
| 上海山崎电路板有限公司    | 投资 2.3 亿元建设二期智能产线，专注 14-24 层高速传输 PCB 生产，下半年正式投产 | 2025 年 6 月验收，下半年投产 |
| 上海展华电子（南通）有限公司 | 赴上海航天科工电器研究院等企业开展技术攻关与人才共享洽谈，深化沪通产业协同           | 2025 年 8 月 19 日    |
| 南亚新材料科技股份有限公司  | 推进年产 120 万平米 IC 载板材料智能工厂暨研发总部建设，上海嘉定基地承担核心研发任务  | 2025 年全年推进         |

|             |                                                                             |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 奥特斯中国有限公司   | 马来西亚居林新工厂正式投产，总投资已达约 50 亿令吉（约 10 亿欧元）                                       | 2025 年 5 月份投产                      |
| 上海山崎电路板有限公司 | 一期工厂于 2025 年 1 月在安美德罗勇工业园开业，目前月产能 3 万平方米，全部建设完成后月产能达 6 万平方米。                | 已正式开业，进入规模化生产阶段                    |
| 美维（安捷利美维）   | 泰国美维泰国大城府 Rojana 工业园高端 HDI 及软板项目                                            | 2025 年 7 月 29 日主厂房封顶               |
| 天承科技        | 上市主体总部从珠海迁址上海张江（首家科创板上市后迁址上海的企业），在浦东金桥布局半导体先进封装材料研发中心，与张江集团下属基金合资成立上海天承微电子。 | 2025 年 7 月 16 日完成，8 月完成金山工厂产能优化升级。 |

#### （四）行业发展前景

2026 开年以来，PCB 行业面临原材料涨价传导、高端产能扩张、AI 驱动技术升级三大主线：

从中期来看，高端 PCB 的供给仍将处于相对紧张的状态，下游有充足的需求消化新增产能。从发展趋势来看，信号传输带宽将持续升级，材料等级不断提高，高多层板、高阶 HDI 的层数、阶数不断增加，这会进一步消耗高端产能，有效产出面积（平米数）呈减少趋势。当然随之而来的是产品价值量、产值能力在不断提升。

AI 与通信技术升级推动高端 PCB 原材料与设备需求同步扩容，高频覆铜板、HVLPC 铜箔、碳氢树脂等特种材料缺口显著，PCB 核心材料铜箔基板（CCL）、黏合胶片开启涨价潮，涨幅高达 30% 以上，企业面临成本控制与替代突破的双重挑战，国产企业正加速高端基材、高端铜箔量产以推进替代；同时，激光钻孔机、高速层压机等精密设备成刚需，设备向高精度、高自动化升级适配超高层数与微小孔径工艺，国产设备持续突破，精准匹配产能扩张需求。

另一方面，中低端 PCB 市场仍然面临同质化竞争和价格战的压力，特别是当前原材料成本高、人力和能源等成本的持续上涨，缺乏核心竞争力和差异化的企业面临被市场优化的风险，造成了资源的浪费。

海外方面，企业海外布局加速背景下，合规经营把控与全球化管理能力提升成为核心课题，需适配不同区域政策法规与运营模式。值得关注的是，国内已形成覆盖“铜箔—玻纤布—覆铜板—PCB—智能终端”的完整产业链，供应链配套体系最为完善，而海外区域配套能力仍有欠缺，不足以对国内 PCB 产业形成大规模转移冲击，这也从侧面凸显了供应链完善对产业稳定发展的核心支撑作用。

## （五）2026 年行业趋势研判

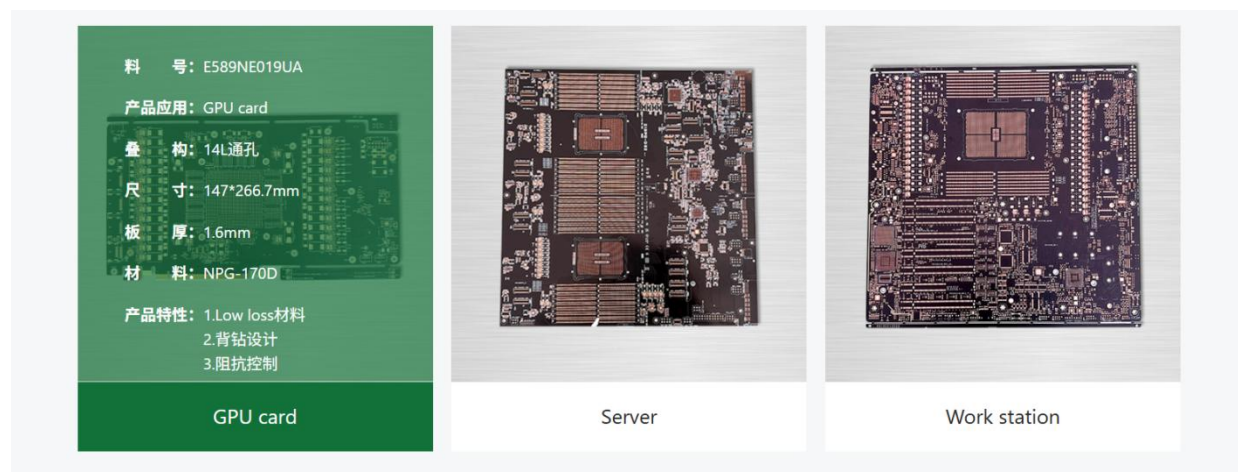
1、- 核心技术突破与商业化：CoWoP 封装技术实现商业化并向 AI 服务器主板渗透，Midplane 超高层 PCB 背板技术取得突破，适配 Rubin 架构；数据中心光互联向 CPO 技术演进并广泛部署。

2、关键材料升级与供需变革：Rubin 架构量产带动 M9 等级 CCL 规模化应用，开启 M9 材料元年；HVLP-4/5 铜箔国产替代加速，Q 布作为核心增强材料供需缺口爆发，玻璃基板进入发展加速期。

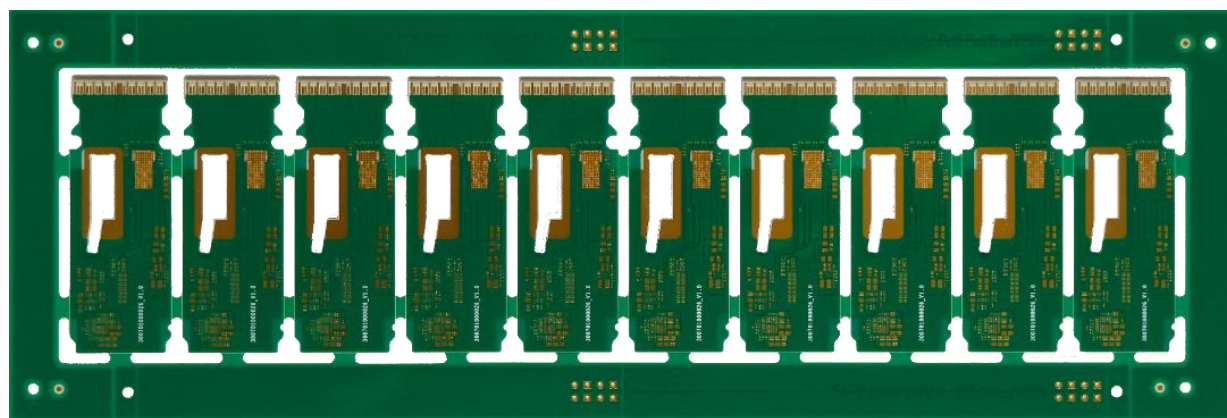
3、国产算力产业链放量验证：国产 AI 芯片迎来性能与生态市场验证关键期，将拉动国内高阶 HDI、高多层板需求超预期增长。

4、AI 终端硬件规模化落地：AI 应用从技术突破走向行业落地，AI 手机、AI 眼镜等终端新品密集发布，开启 AI 硬件创新大年。

5、汽车 AI 算力升级赋能：L3+自动驾驶推动智驾域控 PCB 升级，从单一 HDI 方案转向“高多层+HDI”混合方案。



GPU 主板、服务器主板、工作站主板



1.6T AI 服务器光通信光模块板

## （六）外部挑战和内部问题

外部挑战：国际技术竞争与贸易博弈：印度对华印制电路板、印制电路板用刀具发起

反倾销调查，带来的不良影响；原材料成本与供应压力：黄金税收新规下，PCB 制造企业购买金盐原材料时，成本增加了 7%左右，2026 开年以来，PCB 核心材料铜箔基板（CCL）、黏合胶片开启涨价潮，涨幅高达 30%以上。

内部问题：AI 等高端产品的需求爆发，短时期内需大量的人才，技术创新迭代快速，投资投产周期可能跟不上技术发展速度。核心技术领域的自主创新能力仍有待提升，关键材料和设备的进口依赖度较高，在技术快速迭代的背景下，企业需要持续投入大量资金用于研发，但研发成果转化周期长、不确定性大，可能面临研发投入与市场回报不成正比的风险。

### **（七）企业智造升级力度持续加大**

上海电子电路企业聚焦智能化转型，加大智能产线与数字工厂建设投入：上海山崎电路板投资 2.3 亿元建设二期智能产线，专注 14-24 层高速传输 PCB 生产，通过自动化设备提升生产效率与精准度；南亚新材料推进年产 120 万平米 IC 载板材料智能工厂建设，上海嘉定基地承担核心研发与智能生产任务。同时，企业积极适配 AI 时代生产需求，引入高精度、高自动化生产设备，结合数字化管理系统优化生产流程，协会发起“全球制造业数字化促进中心”提供支撑，行业整体智造水平与生产效能显著提升。

**上海电子电路行业协会**

**2026 年 1 月 23 日**